

ADHESIVE PEEL AND STICK HEAT SINKS



- With pre-applied adhesive, just peel off the release liner and press onto the component
- Reduces assembly costs; no more messy adhesives or greases required
- Excellent mechanical bond
- Thermally optimized pin fin
- Omnidirectional
- Adhesive shear strength at 100°C is 36psi (a one inch square heat sink would require a 36lb. force to remove heat sink)
- Applicable for BGA, PGA, PLCC, and QFP packages



| PART NUMBER*** | SIZE |      |      |     | PIN FIN CONFIGURATION |      |            | THERMAL RESISTANCE CASE TO AMBIENT* °C/WATTS |                              |
|----------------|------|------|------|-----|-----------------------|------|------------|--|------------------------------|
|                | (W)  | (L)  | (H)  | T   | P                     | G    | FIN MATRIX | NATURAL CONVECTION**                         | FORCED CONVECTION @ 400 LFPM |
| BDN09-3CB/A01  | 0.91 | 0.91 | .355 | .09 | .069                  | .072 | 7x7        | 26.9   | 9.6                          |
| BDN09-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .132                  | .128 | 4x4        | 24.5   | 7.7                          |
| BDN10-3CB/A01  | 1.01 | 1.01 | .355 | .09 | .083                  | .072 | 7x7        | 26.4   | 8.0                          |
| BDN10-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .111                  | .114 | 5x5        | 20.8   | 6.3                          |
| BDN11-3CB/A01  | 1.11 | 1.11 | .355 | .09 | .076                  | .072 | 8x8        | 20.9   | 7.2                          |
| BDN11-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .119                  | .128 | 5x5        | 18.5   | 5.7                          |
| BDN12-3CB/A01  | 1.21 | 1.21 | .355 | .09 | .060                  | .081 | 9x9        | 19.6   | 6.8                          |
| BDN12-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .105                  | .114 | 6x6        | 16.5   | 5.2                          |
| BDN13-3CB/A01  | 1.31 | 1.31 | .355 | .09 | .074                  | .081 | 9x9        | 16.1   | 6.0                          |
| BDN13-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .125                  | .114 | 6x6        | 14.9   | 4.7                          |
| BDN14-3CB/A01  | 1.41 | 1.41 | .355 | .09 | .067                  | .081 | 10x10      | 16.2   | 5.6                          |
| BDN14-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .128                  | .128 | 6x6        | 13.1   | 4.2                          |
| BDN15-3CB/A01  | 1.51 | 1.51 | .355 | .09 | .062                  | .081 | 11x11      | 15.1   | 4.5                          |
| BDN15-5CB/A01  |      |      | .555 | .10 | .118                  | .114 | 7x7        | 11.9   | 3.8                          |
| BDN16-3CB/A01  | 1.61 | 1.61 | .355 | .09 | .072                  | .081 | 11x11      | 13.5   | 4.5                          |
| BDN16-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .119                  | .128 | 7x7        | 10.6   | 3.5                          |
| BDN17-3CB/A01  | 1.71 | 1.71 | .355 | .09 | .065                  | .072 | 13x13      | 11.5   | 3.8                          |
| BDN18-3CB/A01  | 1.81 | 1.81 | .355 | .09 | .072                  | .072 | 13x13      | 10.8   | 3.5                          |
| BDN18-6CB/A01  |      |      | .605 | .10 | .128                  | .114 | 8x8        | 8.1  | 2.8                          |
| BDN19-3CB/A01  | 1.91 | 1.91 | .355 | .09 | .069                  | .072 | 14x14      | 9.9  | 2.9                          |
| BDN21-3CB/A01  | 2.11 | 2.11 | .355 | .09 | .064                  | .072 | 16x16      | 8.5  | 2.6                          |

NOTES:

\*Thermal resistance of adhesive tape is included.

\*\*Thermal resistance values based on power density of 3 watts/in<sup>2</sup>

\*\*\*Part numbers listed for standard black anodized heat sinks with CTS adhesive tapes.

All dimensions are in inches.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9